

长春奥普光电技术股份有限公司
关于申报科技重大专项课题“超大口径光学元件超声磨
抛加工技术及装备”项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题责任单位与杭州杭机股份有限公司等单位联合申报科技重大专项课题“超大口径光学元件超声磨抛加工技术及装备”项目。

本课题总研究内容为研制出具有自主知识产权的2000mm 非球面超精密铣磨设备和多自由度快速研抛设备样机；通过开展超声磨削、数控研磨和抛光等工艺研究，揭示大口径光学元件的高精度面形成机理和亚表面损伤演化规律。形成体系完整的SiC/Si、光学玻璃高效光学加工工艺规范；开展在线轮廓测量和光学补偿检验研究，建立满足航天标准要求的试验、检验标准；完成2000mm 口径SiC/Si 的非球面光学反射镜和光学玻璃样件验证。

本课题总经费9200万元，其中中央财政资金4570.48万元、地方财政资金920万元、企业自筹资金3709.52万元。课题预算如下：

序号	单位名称	中央财政经费（万元）	地方财政经费（万元）	自筹经费（万元）
1	长春奥普光电技术股份有限公司	1590.48	920.00	3009.52
2	杭州杭机股份有限公司	1800.00	0	500.00
3	科德数控股份有限公司	200.00	0	200.00
4	大连理工大学	200.00	0	0

5	哈尔滨工业大学	300.00	0	0
6	长春光学精密机械与物理研究所	280.00	0	0
7	上海卫星工程研究所	200.00	0	0
合计		4570.48	920.00	3709.52
总经费合计		9200.00		

公司在本课题中以完成研抛装置集成制造，并开展工艺实验；建立大口径光学元件加工工艺规范、检测技术标准为目标。负责为摇臂式轮廓测量系统、磁流体抛光系统、应力盘抛光装置制造、集成；平转动小磨头抛光装置研制；牵头进行铣磨系统与主机的集成和测试加工等；牵头进行研磨抛光执行单元和主机集成及试加工等。本课题完成后将帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。

公司与长春光机所系根据所申报项目的任务分工完成各自承担的任务内容，公司与长春光机所在项目实施期间不存在因实施项目而发生的自有资金往来、提供或接受劳务、委托销售及其他可能造成资源或者义务在公司与长春光机所之间转移的事项。上述事项经 2017 年 9 月 11 日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过。独立董事对该事项发表同意的独立意见。本项目实施不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的审批权限，上述事项无需获得股东大会的批准。

二、独立董事独立意见

该项目有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

三、风险提示

1、项目处于申报阶段，存在是否获批风险，同时，项目总投资金额以及各方投资金额将以最终批复为准。

2、本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。

四、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2017年9月11日